

工程別にみる半導体製造装置関連銘柄



－ BB レシオが8カ月連続で1 超え －

17日に発表された7月の半導体製造装置のBBレシオは1.23となり8カ月連続で1を上回り需要が供給を上回る状態が続いています。7月の受注額は1298億円で前月からは小幅に減少となったものの、前年同月比では20%を上回る増加となっています。これは記憶素子を立体的に積み上げる3次元NANDフラッシュメモリーへの設備投資が本格化しているためです。

こうしたなか8月19日の日本経済新聞では、「半導体株、円高でも健在」として半導体株にスポットを当てています。18日に為替相場が再び1ドル＝100円を突破し、輸出株総崩れかと思われるなかで唯一、底堅い動きをみせたのが半導体関連で、半導体が中期的な投資テーマに浮上する可能性を秘めていると伝えていきます。

【半導体の製造過程と主な製造装置関連銘柄】

＜前工程＞	
酸化膜形成 (拡散炉で酸化膜を形成)	東京エレクトロン(8035) 日立国際電気(6756)
フォトリソ塗布・洗浄 (感光剤を表面に塗布)	東京エレクトロン(8035) SCREENホールディングス(7735)
露光・パターン形成 (表面に回路を焼き付ける)	ニコン(7731) キヤノン(7751)
現像・エッチング (不要な酸化膜を削除)	東京エレクトロン(8035) 日立ハイテクノロジーズ(8036)
酸化・拡散・CVD・イオン注入 (ウェーハ素子をつくりこむ)	東京エレクトロン(8035) 日新電機(6641) 日立国際電気(6756)
平坦化(CMP) (ウェーハの表面を研磨)	東京精密(7729)
電極形成 (ウェーハの表面に電極を形成)	アルバック(6728)
ウェーハ検査 (検査し不良品をチェック)	東京エレクトロン(8035) 東京精密(7729)

＜後工程＞	
ダイシング (ウェーハをチップに切断)	ディスコ(6146) 東京精密(7729)
ワイヤーボンディング (チップとリードフレームを結ぶ)	新川(6274)
モールド (パッケージで封止)	TOWA(6315) アピックヤマダ(6300)
ファイナルテスト (最終検査)	アドバンテスト(6857)

当社は、本書の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではありません。記載した情報、予想及び判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではありません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではありません。提供する情報等は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更又は削除されることがございます。当社は本書の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。本書の内容に関する一切の権利は当社にありますので、当社の事前の書面による了解なしに転用・複製・配布することはできません。内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめご容赦ください。

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号
加入協会: 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会